

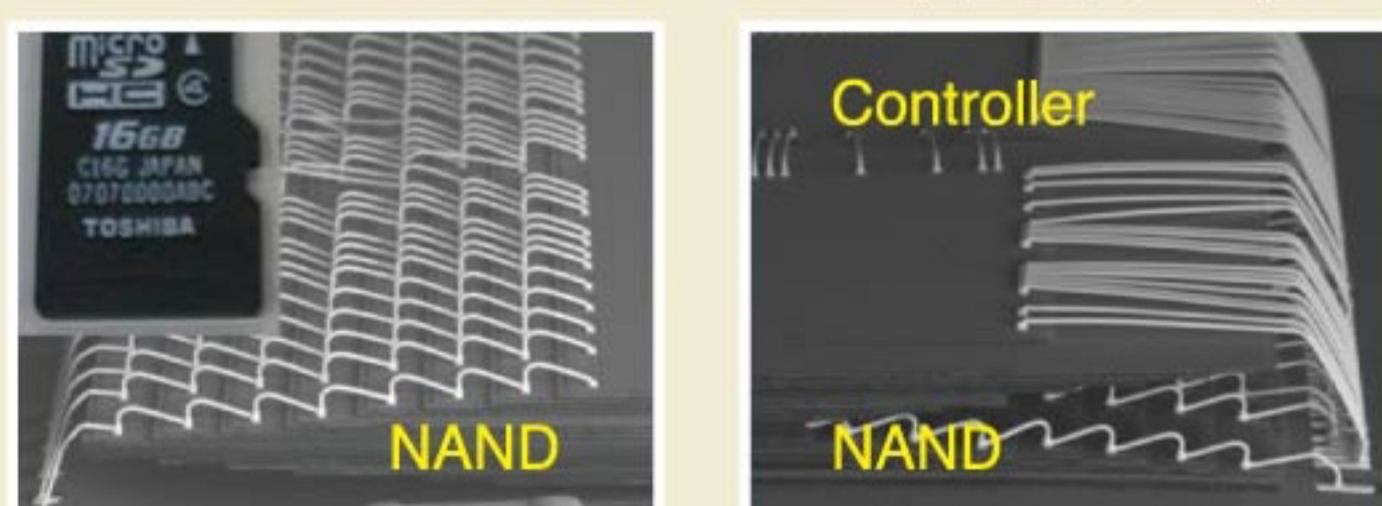
封装技术发展路标



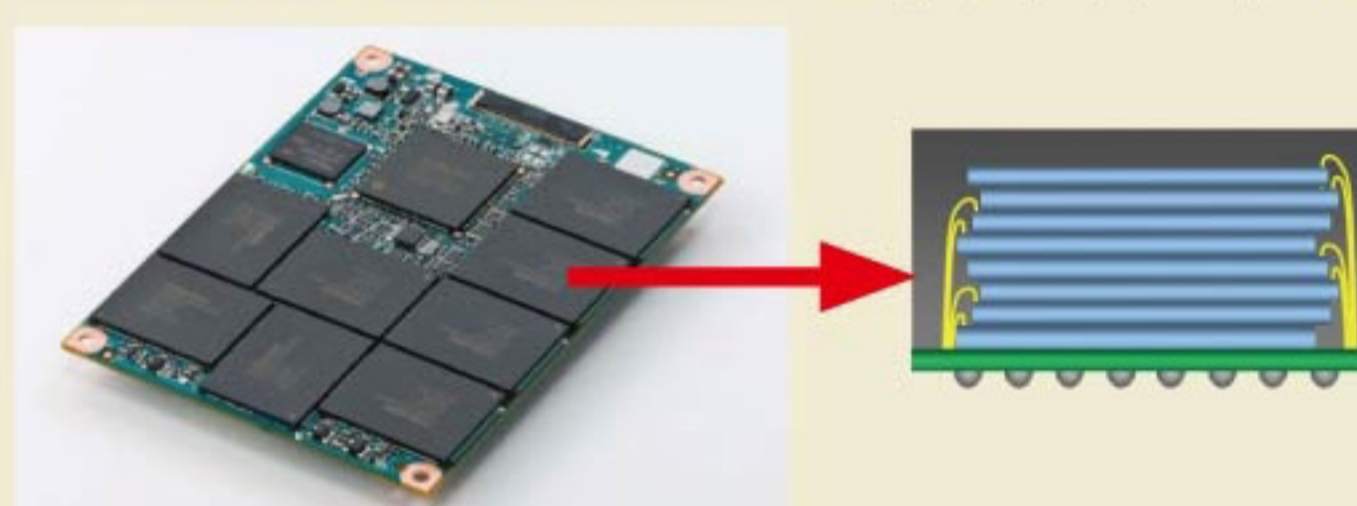
◆ 东芝除了在细微加工技术以外，还推动最先进的贴装技术的开发，不断向存储器技术的革新挑战。

运用更薄芯片、多层化技术，实现移动设备、SSD等中的封装/存储卡更小巧、更薄、功能更强大、容量更大。

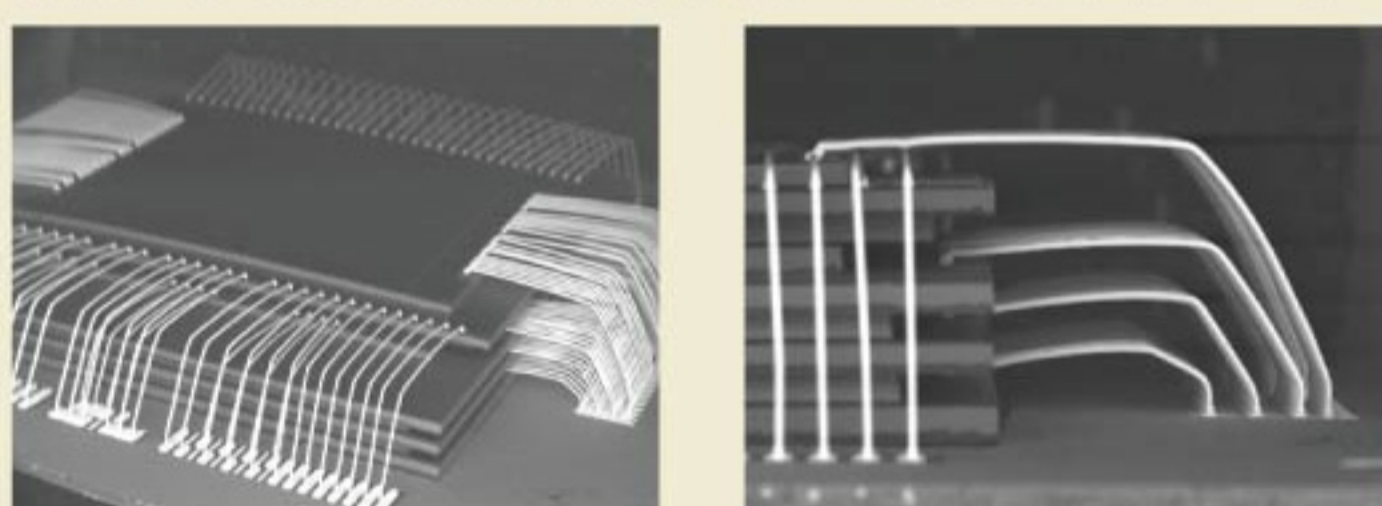
16GB microSD (芯片厚度18 μ m)



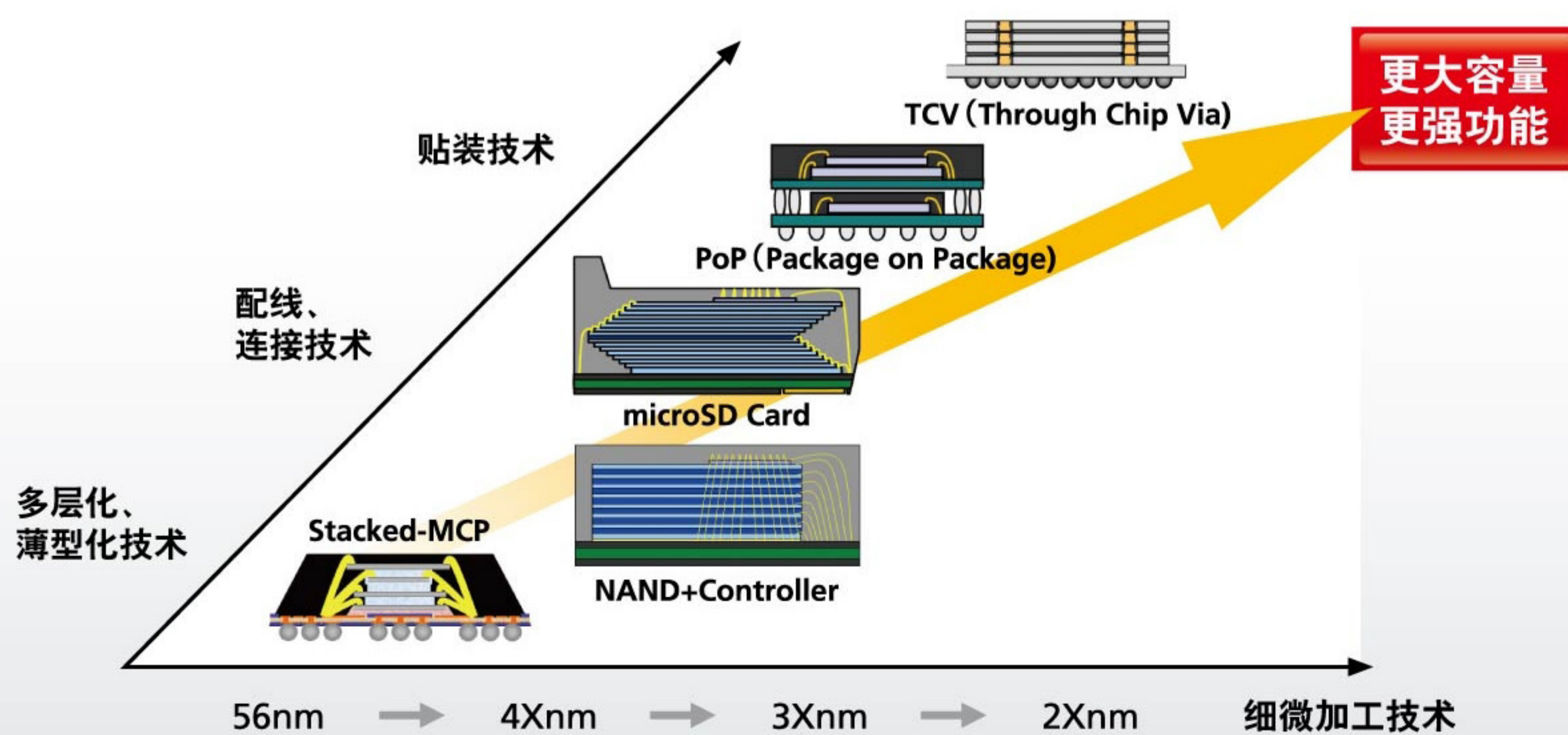
128GB SSD (芯片厚度80 μ m)



9die stacked-MCP (芯片厚度70 μ m)



16,32GB模块 (芯片厚度80 μ m)



*刊登的系统以及产品名，一般均为各公司的注册商标或商标。

TOSHIBA
Leading Innovation >>>